

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于安集微电子科技（上海）股份有限公司**  
**2024年半年度持续督导跟踪报告**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规定，对安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”、“公司”）开展持续督导工作，并出具2024年半年度持续督导跟踪报告。

**一、持续督导工作情况**

序号	工作内容	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并制定了相应工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与安集科技签订了保荐协议，明确双方在持续督导期间的权利义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2024年半年度持续督导期间，公司未发生需按有关规定公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2024年半年度持续督导期间，安集科技及相关当事人不存在违法违规和违背承诺的情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2024年半年度持续督导期间，安集科技及其董事、监事、高级管理人员无违法违规和违背承诺的情况

7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	安集科技执行《公司章程》、三会议事规则等相关制度,上述制度的履行情况均符合相关法规要求,并督促公司严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	安集科技内控制度符合相关法规要求,可以保证公司的规范运行,督促公司严格执行内部控制制度
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	公司已按照证券监管部门的相关要求建立了信息披露制度。2024年半年度持续督导期间,安集科技向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	2024年半年度持续督导期间,保荐机构对安集科技的信息披露文件及向上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅,公司给予了积极配合。截至本报告出具日,不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况
11	上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	在2024年半年度持续督导期间,安集科技或其控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2024年半年度持续督导期间,安集科技及控股股东不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2024年半年度持续督导期间,未发现安集科技该等事项

14	发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2024年半年度持续督导期间,安集科技未发生该等情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日15日内进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(三)可能存在重大违规担保;(四)资金往来或者现金流存在重大异常;(五)上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2024年半年度持续督导期间,安集科技未发生该等情况
16	持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	2024年半年度持续督导期间,保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注

## 二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况

保荐机构持续督导人员对公司2024年半年度的信息披露文件进行了事先或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查,保荐机构认为,安集科技严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类定期报告或临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 四、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

### **（一）产品开发风险**

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，对于产品技术创新要求较高。在下游产品不断提出更高技术要求的前提下，对上游关键半导体材料的要求也在不断提高，公司需要对客户需求进行持续跟踪研究并开发满足客户需求的产品。如果公司未来不能准确地把握技术发展趋势，在产品开发方向上的战略决策上出现失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将使得公司产品开发的成功率受到影响，持续大量的研发投入成本无法回收，进而对公司经营造成不利影响。

### **（二）核心技术失密及核心技术人员流失的风险**

公司产品技术壁垒高，研发及产业化需要大批专业背景深厚、实践经验丰富的高层次技术人才。公司核心技术涵盖了整个产品配方和工艺流程，核心技术人员对公司持续科技创新及客户技术支持服务至关重要。虽然公司通过申请专利或者技术秘密等形式对核心技术予以保护，但仍存在核心技术失密的风险。随着行业内人才竞争日趋激烈，如果公司的薪酬制度、激励机制不能持续保留和吸引优秀人才，可能会导致公司的核心技术人员流失，进而对公司的核心竞争力和业务发展产生不利影响。

### **（三）客户集中度较高风险**

2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年上半年，公司向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比分别为 84.45%、82.47%、80.49%和 75.81%。公司销售较为集中的主要原因系国内外集成电路制造行业本身集中度较高、公司产品定位领先技术的特点和“本土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司主要客户均为国内外领先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者主要客户因各种原因大幅减少对公司的采购量或者要求大幅下调产品价格，公司的经营业绩可能出现下降。

### **（四）原材料供应及价格上涨风险**

目前公司生产所需的部分主要原材料采购来源以进口为主。2021 年度、2022

年度、2023 年度和 2024 年上半年，公司向前五名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比分别为 51.27%、52.81%、47.09%和 46.75%，采购相对集中。如果公司主要供应商的供货条款发生重大调整或者停产、交付能力下降、供应中断等，或者进出口政策出现重大变化，或者出现国际贸易摩擦，或者原材料采购国采取出口管制，或者公司主要原材料价格受市场影响出现上升，将可能对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格产生不利影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

此外，公司主要从上游基础化工或精细化工行业采购原材料，随着环保政策趋严，供应趋紧，原材料价格可能存在上涨的风险。

#### **（五）安全环保风险**

公司主要生产产品的生产过程为配方型复配工艺，以复配、混合、过滤等工艺为主，生产环节不存在高危险、重污染的情况。虽然公司严格遵守安全生产方面的法律法规要求，并针对生产过程中少量“三废”排放采取了相应的防治措施，但如果公司在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故，或者发生因环保设施故障、污染物外泄等原因导致的环保事故，将对公司的生产经营产生不利影响。

#### **（六）存货管理风险**

2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年上半年，公司采用上线结算方式的主要客户收入占比分别为 78.17%、73.38%、68.32%和 63.34%。公司根据客户需求将货物发往客户指定的仓库时，从库存商品转入发出商品。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司发出商品账面余额分别为 3,626.81 万元、4,739.01 万元、3,177.07 万元和 3,396.90 万元，占存货账面余额的比例分别为 15.66%、12.80%、7.32%和 6.69%。公司已与采用上线结算方式的客户约定发出商品的管理机制和保管、灭失等风险承担机制，但若双方对保管责任的界定不一致或者遇不可抗力导致的风险，公司发出商品面临减值的风险。

#### **（七）税收优惠及政府补助政策风险**

2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年上半年，公司税收优惠金额分

别为 3,304.56 万元、5,694.93 万元、6,351.14 万元和 4,829.38 万元，占利润总额的比例分别为 25.02%、16.79%、14.42%和 19.31%。如果国家有关高新技术企业等税收优惠的法律、法规、政策发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法获得税收优惠，将对公司经营业绩造成不利影响。

2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年上半年，公司计入其他收益的政府补助（包括增值税加计扣除）分别为 2,647.34 万元、1,190.79 万元、10,430.16 万元和 1,870.36 万元，占利润总额的比例分别为 20.05%、3.51%、23.68%和 7.48%。如果未来政府部门对相关产业的政策支持力度减弱，或者其他补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助将会减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

#### （八）汇率波动风险

公司销售商品、进口原材料中使用美元结算的比例较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年上半年，受人民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损益的金额分别为-580.71 万元、3,171.68 万元、780.72 万元和 568.29 万元。随着生产、销售规模的扩大，公司外汇结算量将继续增大。如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购价格和产品销售价格仍将直接受到影响，进而可能对经营业绩造成不利影响。

#### （九）半导体行业周期变化风险

目前公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于下游消费电子、计算机、通信、汽车、物联网等终端应用领域需求的持续增长，全球半导体特别是集成电路产业实现了快速发展。近年来，全球公共卫生事件、高通胀以及局部地区冲突等因素给宏观经济带来负面影响，加上智能手机、个人电脑等消费性电子市场需求薄弱，导致全球半导体产业进入阶段性增速放缓阶段，并于 2022 年第二季度开始进入本轮下行周期。根据 WSTS 统计及预测，2023 年全球半导体市场规模受通胀加剧、终端市场需求疲软等负面因素影响下降 8.2%，预计 2024 年和 2025 年同比增幅分别为 16.0%和 12.5%。由于全球半导体行业景气周期与宏观经济、下游终端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，如果未来半导体行业复苏不及预期或者市场需求因宏观经济或行业环境等原因出现下滑，将对

公司经营业绩产生不利影响。

### (十) 全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力风险

当前全球经济处于周期性波动当中，叠加全球政治环境不稳定等因素的影响，尚未出现经济全面复苏的趋势，面临下滑的可能。随着全球主要经济体经济增速放缓，贸易保护主义及国际贸易摩擦的风险仍将存在。如果国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下游客户需求或者订单量产生不利波动，进而影响公司业绩。此外，如果发生自然灾害、战争或其他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、下游市场及公司经营业绩造成影响。

### 五、重大违规事项

2024年半年度，公司不存在重大违规事项。

### 六、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	797,273,450.87	574,910,253.78	38.68
归属于上市公司股东的净利润	233,995,840.71	235,014,487.04	-0.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,841,919.38	160,769,402.71	46.07
经营活动产生的现金流量净额	195,294,022.80	158,244,850.22	23.41
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,348,282,731.19	2,124,045,086.38	10.56
总资产	2,999,615,904.96	2,603,401,095.73	15.22

2024年半年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.82	1.84	-1.09
稀释每股收益(元/股)	1.82	1.84	-1.09
扣除非经常性损益后的基本	1.82	1.26	44.44

每股收益（元/股）			
加权平均净资产收益率（%）	10.38	13.47	减少 3.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.42	9.21	增加 1.21 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	18.13	17.62	增加 0.51 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 79,727.35 万元，较上年同期增长 38.68%，主要原因系公司持续加大产品研发和产品商业化的多方位布局，同时不断加强与客户合作交流，积极扩充产品品类，产品研发及市场拓展均按预期顺利推进。

归属于上市公司股东的净利润为 23,399.58 万元，较上年同期下降 0.43%，主要系上年同期集中完成了部分政府补助项目验收，确认其他收益约 8,000 万元，导致同比基数较高。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 23,484.19 万元，较上年同期增长 46.07%，主要系公司在积极扩大研发和生产建设投入的同时，持续提高盈利能力和经营管理水平，从而实现扣除非经常性损益的净利润持续增长。

经营活动产生的现金流量净额为 19,529.40 万元，较上年同期增长 23.41%，主要系营业收入增长带来的客户回款增加所致。

归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长 10.56%，主要系公司 2024 年半年度经营积累所致。

归属于上市公司股东的总资产较上年度末增长 15.22%，主要系公司 2024 年半年度经营积累及公司研发和生产建设持续投入所致。

基本每股收益和稀释每股收益较上年同期下降 1.09%，与净利润变动保持一致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 44.44%，主要系扣除非经常性损益的净利润增长所致。

加权平均净资产收益率较上期下降 3.09 个百分点，主要系上年同期因政府补助导致归属于上市公司股东的净利润同比基数较高所致。

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上期增加 1.21 个百分点，



主要系公司在收入增长的同时，持续降本增效，经营效率稳步提高。

研发投入占营业收入的比例为 18.13%，较上年同期增加 0.51 个百分点，主要由于公司着眼于未来市场及业务拓展方向，持续保持研发投入，加速扩充研发能力，不断提升研发水平。

综上，公司报告期主要财务数据及指标变动具有合理性。

## 七、核心竞争力的变化情况

2024 年半年度，公司核心竞争力未发生不利变化。公司核心竞争力体现在：

### （一）深耕高端半导体材料领域

公司自成立之初就将自己定位为以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料供应伙伴，始终围绕液体与固体衬底表面处理和高端化学品配方核心技术并持续专注投入，成功搭建了“3+1”技术平台，为公司持续产品开发及产业化提供了坚实的技术基础。随着集成电路技术的不断推进，以及新结构、新器件和新材料的引入，工艺复杂性和技术挑战不断增加，下游客户对关键半导体材料的要求也不断提高且呈现多样化，因此满足客户定制化需求将成为集成电路关键材料发展的重要趋势，能够与行业领先客户联合开发或定制开发是公司产品成功产业化的关键条件。公司紧密围绕现有核心技术平台，结合市场需求及相关领域技术进程，持续为客户提供更全面、更具竞争力的产品组合和技术解决方案。通过多年持续投入，公司已拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，成熟并广泛应用于公司产品中。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有境内外授权发明专利 295 项。同时，公司持续加强知识产权管理，依照国家《企业知识产权管理规范》制订了完善的知识产权管理体系，并通过了国家知识产权管理体系认证。公司通过完善的知识产权布局保护核心技术，持续创新并更新知识产权库，实现产品和技术的差异化，为公司开发新产品和开拓新业务创造了有利条件。

未来，公司将凭借在高端半导体材料领域积累的宝贵经验持续深耕，依托已有的先进技术平台和人才团队为客户提供高附加值的产品和服务。

### （二）高效的研发和产品转化能力

公司致力于为集成电路产业提供以创新驱动的、高性能并具成本优势的产品和技术解决方案，从解决方案设计、产品研发、测试认证、供应保障、物流配套、技术支持等方面着手，提供全生命周期、全价值链的一站式服务。公司坚持创新驱动和客户至上的理念，利用在化学配方、材料科学等领域的专长，持续研发创新产品或改进产品以满足下游技术先进客户的需求，将客户面临的具体挑战转化成现实的产品和可行的工艺解决方案。

最近三年及本报告期，公司研发费用分别为 15,310.78 万元、16,136.46 万元、23,661.27 万元和 14,456.52 万元，分别占营业收入的比例为 22.30%、14.99%、19.11%和 18.13%，研发投入持续保持在较高水平。公司持续投入大量的资金、人力等研发资源，将重点聚焦在产品创新上，以满足下游集成电路制造和先进封装行业全球领先客户的尖端产品应用。得益于有竞争力的商业模式，公司产品研发效率高且具有针对性，近年来持续、及时推出了符合市场和客户需求的新产品，量产经验持续丰富。

### **（三）可靠的原材料供应能力**

公司在原材料采购及供应渠道方面积累了丰富的资源，与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作伙伴关系，并积极拓展供应资源。同时，公司依托于公司通过长期积累已搭建的核心技术平台，纵向深入研究上游关键原材料，通过自建、合作等多种方式加快建立核心原材料自主可控供应的能力，拓宽供应品类，保障长期供应的可靠性。

### **（四）国际化、多元化的人才储备**

通过多年的集成电路制造及先进封装领域的研发实践，公司组建了一批高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队。最近三年及报告期末，公司研发人员数量分别为 145 人、180 人、236 人、264 人，占员工总数的比重分别为 43.81%、45.69%、50.43%、50.09%，研发人才占比保持高位。公司核心技术团队均由资深行业专家组成，在化学、材料化学、材料工程等专业领域有着长达几十年的研究经验，并在半导体材料行业深耕积累了数十年的丰富经验和先进技术。公司核心管理团队也在战略规划、行业发展、人才培养、团队建设、销售与市场、跨国公司等管理等方面拥有丰富经验。公司管理团队在半导体材料及相关行业的丰富经验

为公司的业务发展带来了全球先进乃至领先的视角。公司高素质的员工队伍为维持竞争优势提供了保证。

与此同时，公司持续加大后备人才引进和培养，整合优势资源，进一步提升公司整体综合实力。团队规模逐渐扩大的同时，团队能力培养初见成效，公司加大培训投入，在识别和分析公司人才需求的基础上，针对性地组织内外部培训、研讨交流会、知识分享会，始终贯彻了“终身学习”的理念，构建了结构化、多元化、体系化的学院式培训，有效提升员工的综合素质能力。

#### **（五）贴近市场和客户的服务模式**

公司根植于全球半导体材料的第一大和第二大市场，布局富有经验的应用工程师团队在当地提供 24 小时服务。根据 SEMI，中国台湾和中国大陆是全球前两大半导体材料消费地区，2023 年销售额分别为 192 亿美元和 131 亿美元，占全球半导体材料销售额的比重分别约 29%和 20%，其中中国大陆是 2023 年全球唯一实现半导体材料销售额同比增长的地区。贴近市场和客户的服务模式有利于公司及时响应客户需求，运输时间短，运输成本低，并且与本土客户文化融合程度高，沟通效率高，具有较强的灵活性。

#### **（六）规范的管理体系和卓越的运营能力**

公司始终秉承“使命必达”的工作态度和服务宗旨，以高标准、严要求建立健全了以内部控制为中心的一系列政策体系、管理流程和机制，以全面防范应对各项风险危机。质量管控方面，公司围绕产品导入的全流程建立了成熟有效的产品质量保证体系，在产品研发、供应商管理、进料控制、过程控制、出货控制、客户服务、产品优化和迭代等方面进行全流程质量管控并已通过 ISO9001,ISO14001,ISO45001 等管理体系的第三方认证。报告期内，公司以高效、积极状态推进生产、运营高质量发展，不断加强研发、生产、质量、供应链等全流程管理，提升自动化和信息化水平，不断改进、完善并夯实 ESH 管理流程的落实和监管，在各项业务有序推进的同时，重大建设项目也按预期完成交付。

### **八、研发支出变化及研发进展**

2024 年半年度，公司研发费用为 144,565,200.86 元，研发费用较去年同期增

长 42.72%，研发费用占营业收入的比重为 18.13%，主要系物料消耗、资产折旧与摊销、人力成本等增长所致。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司在研项目研发进展情况如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	铜抛光液系列产品	用于先进技术节点的产品稳定上量。具有更高性价比的迭代产品在多个客户端验证顺利，逐步上量。	持续开发用于先进技术节点的产品平台和优化用于成熟技术节点的具有更高性价比的产品并在客户端测试验证。	达到国际先进水平	产品满足成熟制程和先进制程的技术要求，具有成长空间。
2	阻挡层抛光液系列产品	用于先进技术节点的产品实现量产，在客户端持续验证扩大销售。具有更高性价比的产品迭代正在进行，逐步量产销售。	持续开发用于先进技术节点的产品平台和优化用于成熟技术节点的具有更高性价比的产品并在客户端测试验证。	达到国际先进水平	产品满足成熟制程和先进制程的技术要求，具有成长空间。
3	钨化学机械抛光液	用于更先进技术节点的产品在客户端通过验证实现销售。成熟技术节点的产品并在客户端验证，扩大应用范围。	持续开发用于先进技术节点的产品并在客户端测试验证；持续优化用于成熟技术节点的产品并在客户端验证，扩大应用范围。	达到国际先进水平	产品满足成熟制程和先进制程的技术要求，具有成长空间。
4	硅衬底抛光液系列产品	硅精抛液产品验证顺利，逐步量产销售。	持续开发和优化硅精抛液并在客户端验证，扩大市场份额；持续优化硅粗抛液并在客户端验证。	达到国际先进水平	逐步完善产品，扩大应用和市场份额。
5	基于氧化铈的抛光液系列产品	用于更具性价比的成熟技术节点的产品已经通过客户测试，逐步导入量产销售；面向先进技术节点相关产品已在海外关键客户导入验证迭代。	持续开发和优化用于成熟技术节点和先进技术节点的产品并在客户端进行测试验证，扩大应用范围。	达到国际先进水平	逐步完善产品，扩大应用和市场份额。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
6	介电材料抛光液系列产品	用于先进逻辑芯片制程工艺的氮化硅抛光液持续在客户端验证，在先进存储芯片工艺中实现销售。氧化硅抛光液正在逐步实现研磨颗粒国产化，部分产品已经通过验证上限。	持续开发和优化氮化硅抛光液并在客户端测试验证；开发具有更高性价比的氧化硅抛光液在客户端测试验证。	达到国际先进水平	逐步完善产品，扩大应用和市场份额。
7	新材料新工艺用抛光液系列产品	用于三维集成工艺的TSV铜/阻挡层抛光液、混合键合抛光液、聚合物抛光液持续在更多的客户端作为首选供应商上线使用，逐步扩大销售。	持续与客户合作，完成新材料用抛光液和三维集成用抛光液的开发和测试，扩大应用。	达到国际先进水平	持续扩大应用和市场份额。
8	刻蚀后清洗液	用于先进技术节点的产品在客户端持续扩大销售，新技术需求产品持续研发验证中。先进技术节点产品批量量产。	持续与客户合作，完成先进技术节点刻蚀后清洗液开发及产业化	达到国际先进水平	逐步完善产品，扩大应用和市场份额。
9	光刻胶剥离液	批量应用于晶圆级封装等超越摩尔领域中，并持续扩大应用，新技术需求产品持续迭代中。	厚膜光刻胶剥离液持续优化，满足超越摩尔等产品需求	达到国际先进水平	满足先进技术节点需求，市场前景广阔。
10	刻蚀液	成功建立刻蚀液技术平台，刻蚀液研发及验证正在按计划进行中。	开发适用于12英寸先进制程独特配方型刻蚀液，支持先进工艺发展	达到国际先进水平	满足先进技术节点需求，市场前景广阔。
11	电镀液	完善集成电路大马士革工艺及先进封装电镀产品线，先进封装电镀产品批量量产。	建立电化学镀技术平台，开发满足集成电路大马士革工艺及先进封装凸点工艺等电镀液添加剂并进行产业化	达到国际先进水平	满足集成电路大马士革工艺及先进封装需求，市场前景广阔。
12	电子级添加剂纯化	成功建立电子级添加剂纯化技术平台，多款添加剂纯化达到ppb级别，并实现量产，新技术需求产品持续研发验证中。	开发电子级添加剂纯化技术，实现原材料自主可控	达到国际先进水平	满足先进技术发展需求，有效支持公司长期发展。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
13	高端纳米磨料	部分产品已通过客户端测试验证，进入量产阶段。	抛光指标和性能达到国际先进水平	达到国际先进水平	客制化磨料与进口磨料互补，保障供应安全。

### 九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

### 十、募集资金使用情况及是否合规

#### （一）首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司累计使用首发募投项目募集资金498,268,867.89元，余额为人民币0.00元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到募集资金	483,927,759.01
减：募投项目累计使用金额	498,268,867.89
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	11,275,870.74
使用募集账户支付的募投项目款	399,870,018.82
超募资金永久补充流动资金	48,428,548.77
节余募集资金永久补充流动资金	38,694,429.56
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	3,335,522.68
减：支付的其他发行费用	5,700,334.53
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	23,376,966.09
截至2024年6月30日募集资金余额	0.00

#### （二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金114,518,194.51元，余额为人民币92,496,629.41元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到募集资金	206,546,218.90

项目	金额
减：募投项目累计使用金额	114,518,194.51
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	6,713,584.00
使用募集账户支付的募投项目款	83,486,215.03
使用募集账户补充的流动资金	24,119,073.28
募集账户结余利息永久补充流动资金	199,322.20
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	2,445,791.92
减：支付的其他发行费用	481,353.70
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	3,395,750.64
截至2024年06月30日募集资金余额	92,496,629.41

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理使用制度》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 十一、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押冻结及减持情况

截至2024年6月末，公司控股股东 Anji Microelectronics Co., Ltd.（以下简称“Anji Cayman”）直接持有公司股票 39,810,936 股，所持股份不存在质押、冻结的情况。2024 年上半年 Anji Cayman 不存在减持公司股份的情况。公司无实际控制人。

截至2024年6月末，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	期初持股数	期末持股数	增减变动的 原因
1	Shumin Wang (王淑敏)	董事长	-	-	-
2	Zhang Ming (张明)	董事、总经理	65,520	63,882	分红送转及其他
3	Chris Chang Yu (俞昌)	董事	-	-	-
4	杨磊	董事	-	-	-

序号	姓名	职务	期初持股数	期末持股数	增减变动的 原因
5	杨逊	董事、副总经理、 董事会秘书	43,680	56,784	分红送转
6	井光利	独立董事	-	-	-
7	Tian-Shen Tang (汤天申)	独立董事	-	-	-
8	李宇	独立董事	-	-	-
9	高琦	监事	-	-	-
10	陈智斌	监事	-	-	-
11	冯倩	监事会主席、职 工代表监事	-	-	-
12	Yuchun Wang (王雨春)	副总经理	43,680	56,784	分红送转
8	刘荣	财务总监	-	-	-

注1：上表持股数量为董事、监事、高级管理人员的直接持股情况；

注2：Shumin Wang（王淑敏）、Chris Chang Yu（俞昌）通过Anji Cayman间接持有公司股份；Yuchun Wang（王雨春）除直接持有公司股份外，还通过Anji Cayman间接持有公司股份；杨逊除直接持有公司股份外，还通过宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

截至2024年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结的情形。2024年1-6月，除公司董事兼总经理Zhang Ming（张明）外，公司其他董事、监事、高级管理人员直接持有的公司股份不存在减持的情形。

## 十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）



(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技(上海)股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



康 杰



周 毅

申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
2024 年 8 月 30 日

